

TIR® 26000-035 以导热填料为主体，经工艺优化让填料在聚合物基体中形成连续贯通的传热网络，构筑高效热量传递通道，有效提升导热能力，可应对基站、大功率芯片等高功率密度应用的散热挑战。材料密度低，兼具出色的抗压缩变形能力与优异的压缩回弹特性，可适配狭小装配空间，兼顾生产制程效率与产品长期使用可靠性。



特性

- 》低热阻
- 》高回弹
- 》低渗油
- 》热性能稳定可靠

应用

- 》消费电子
- 》通信设备
- 》功率器件
- 》数据中心

TIR® 26000-035 系列特性表

产品特性	典型值			测试方法
颜色	金属灰色			目视
标准尺寸 (mm)	90×90			ASTM D5947
厚度 (inch/mm)	0.020 0.50	0.040 1.00	0.080 2.00	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	≤1			ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40~125			ZKTM J025
热阻抗 (°C·in ² /W) @50psi	0.030	0.045	0.080	ASTM D5470
回弹性 (%) @材料厚度2.0mm, 压缩至1.5mm	≥80			ZKTM L005
压缩应力 (psi) @50%	≤50			ASTM D575
渗油率 (%)	≤1.5			ZKTM G030
RoHS2.0	符合			IEC 62321
REACH标准	符合			EC 1907/2006
无卤要求	符合			EN 14582

储存条件

- 1、阴凉避光处存放
- 2、建议储存温度：≤35℃，建议储存湿度：≤75%
- 3、堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1米

注意事项

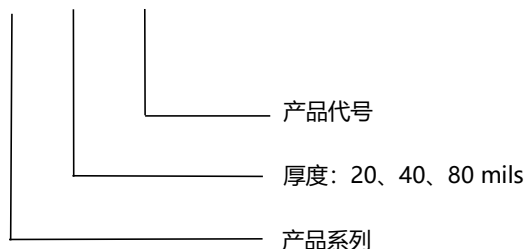
- 1、使用前请确认产品完好
- 2、去除时可使用普通湿巾或酒精湿巾擦拭
- 3、本产品具有导电性，非绝缘材料

产品规格

TIR®系列可提供不同厚度及尺寸规格，
如需了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系

产品型号说明

TIR26 000 - 035



全球方案：在地服务

中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIR26000-035-1026